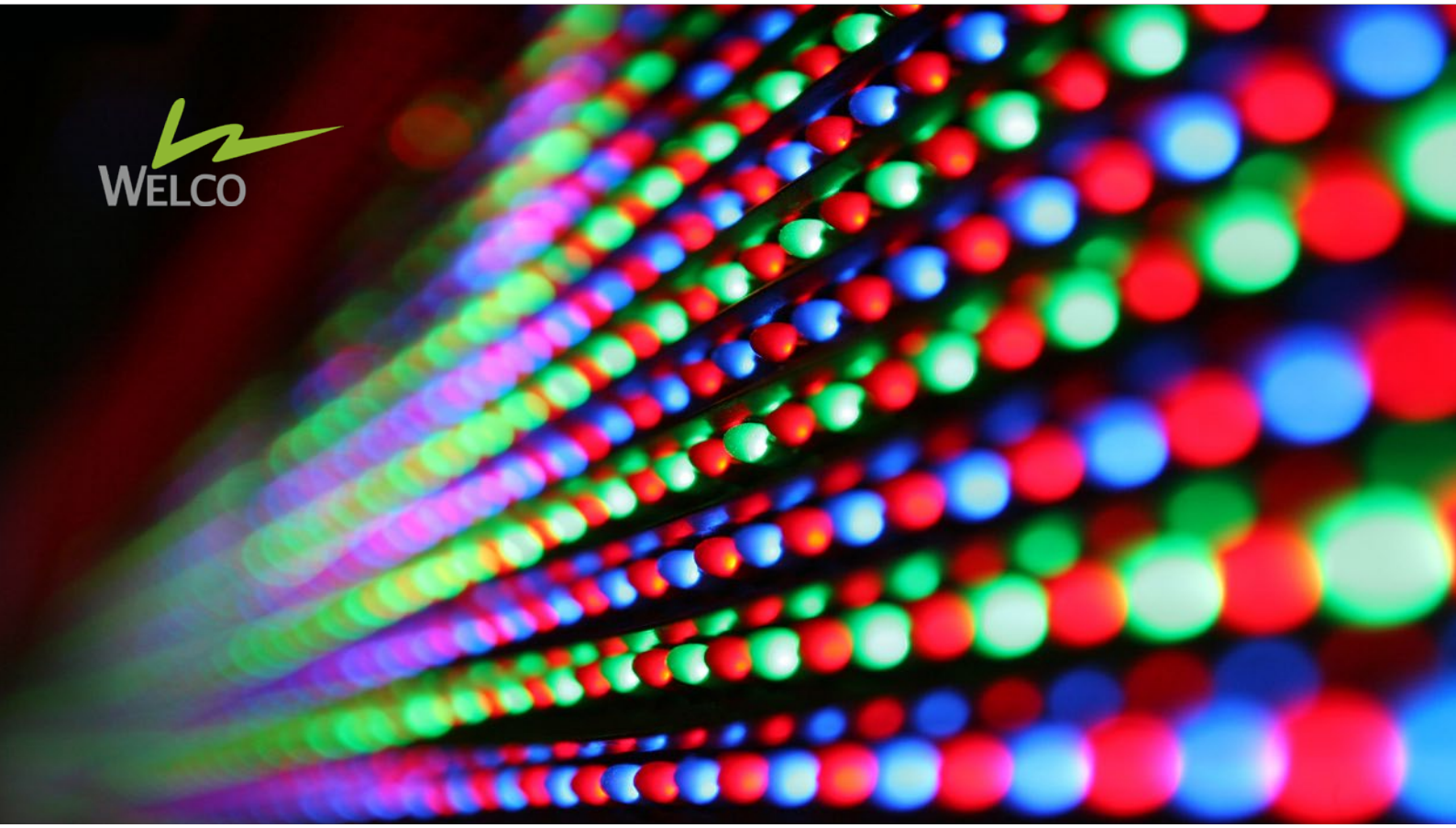
Heraeus

Electronics



Welco LED120
免清洗型 SAC305 T7 号粉印刷锡膏

Welco LED120 SAC305 T7 是一款采用领先技术的免清洗型印刷锡膏，主要针对 MiniLED 和 MicroLED 芯片焊接而设计。在钢网最小开孔为 70μm 时锡膏脱模性能极佳，连续印刷性非常稳定。LED120 系列使用贺利氏专有的 Welco 7 号锡粉制造技术，可实现极高的焊接可靠性，且空洞率低，充分满足客户的应用要求。

主要优势

- 使用高品质 Welco SAC305 T7 号锡粉
- 无卤素，免清洗
- 极低空洞率
- 大幅减少锡珠
- 在细间距印刷中锡膏脱模性能稳定
- 钢网使用寿命长（≥10 小时），印刷后作业时间长（≥10 小时）
- 在 MiniLED 应用中证明了其出色的可靠性和焊接强度

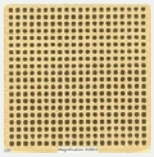
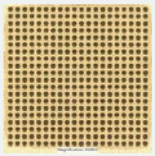
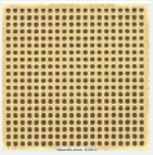
最终应用

- MiniLED 和 MicroLED 背光（电视、平板、电视墙等）
- 系统级封装（手机、可穿戴设备等）

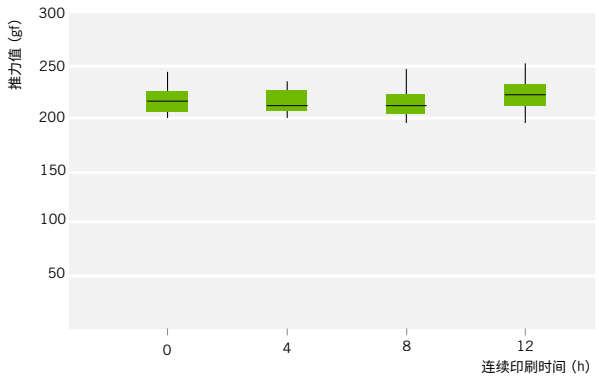
高品质 Welco 7 号锡粉
- 锡粉颗粒度分布集中
- 锡粉球形度好
- 批次间差异小

应用 / 工艺

适用于 MiniLED 和 MicroLED 芯片焊接和 SiP 芯片倒装焊接和无源器件贴装工艺

连续印刷	0 小时	4 小时	8 小时	12 小时
空洞率（<10%） 008004 无源器件贴装后回流焊 X 射线检测				
在细间距印刷中焊锡膏脱模性能稳定 钢网开孔：70μm 开孔间隔：50μm				

器件推力测试



- 008004 无源器件具有稳定的高推力
- 焊盘尺寸 130×140μm，化镍金表面处理

产品特性	LED120 T7 号粉焊锡膏
合金	Sn/Ag3/Cu0.5
熔点	217 - 219 °C
焊粉类型	7 号 Welco 锡粉
粒径	2 - 11 μm
卤素含量	无卤素
助焊剂类型	免清洗型 / 溶剂清洗型
应用	印刷

美洲
电话 +1 610 825 6050
electronics.americas@heraeus.com

亚太区
电话 +65 6571 7649
electronics.apac@heraeus.com

中国
电话 +86 53 5815 9601
electronics.china@heraeus.com

欧洲、中东和非洲
电话 +49 6181 35 4370
electronics.emea@heraeus.com

本文所述事实与技术数据均由贺利氏利用最新知识和现代实验设备根据通用实验流程测定得出。文中信息均为出版前最新版本（可索要最新版本文件）。尽管数据均准确无误，但贺利氏对上述数据是否得到合理引用或因引用上述数据导致的任何侵权后果均不承担任何责任（除非事先以协议的形式征得明确的书面同意）。使用者应根据本文所提供的数据针对特定应用对材料适用性进行测试。贺利氏标识、贺利氏、Heraeus 和 Welco® 图形商标均为贺利氏集团或其附属公司的商标或注册商标。保留所有权利。

Heraeus Electronics GmbH & Co.KG, 63450 Hanau, Germany
网站： www.heraeus-electronics.com

文件编号：HET24270SCN-0122-2 | 版本：2021